



PROGRAMA

XXII Congreso Internacional Adhesión y Adhesivos

2023
16-17 nov.

WORKSHOP

15 nov.
MÁLAGA

www.congreso adhesivos.com

COLABORADORES



PATROCINADOR



ORGANIZADORES



Miércoles 15 noviembre 2023

9:00	<i>Apertura</i> Workshop "Los adhesivos como elementos clave en el desarrollo del packaging sostenible"
9:10	Adhesivos para packaging: retos y oportunidades Carlos Ruzafa Silvestre (ASEFCA)
9:45	El caucho como oportunidad para un packaging más sostenible: desarrollos estireno-butadieno para adhesivos hot-melt libres de aceite Alicia de San Luís González (Grupo Dynasol)
10:20	Obligaciones y Oportunidades para los envasadores del sector adhesivos según el nuevo RD 1055_2022. Presentación SCRAP de IMPLICA Laura Sanz de Siria (CONFECOI)
10:55-11:30	COFFE BREAK
11:30	Estudios de migración de adhesivos biodegradables para contacto alimentario Paula Vera Estacho (Universidad de Zaragoza)
12:05	Ecodiseño de envases. Influencia de los adhesivos en el diseño de packaging Rosa Ocaña López (Universidad Politécnica de Madrid)
12:40	Evaluar el impacto ambiental de los adhesivos en el packaging: una prioridad sostenible Borja Mateu Romero (INESCOP)
13:15-14:50	LUNCH
14:50	Nuevos adhesivos para la fabricación de embalaje sostenible de papel y cartón Alicia Gordon Vergara (QUILOSA-Selena Iberia)
15:25	Los adhesivos como elemento clave en el desarrollo de envases multicapa sostenibles Teresa Calvo (ITENE)
16:00	Ayudas Públicas para apoyar las actividades de I+D+I en adhesivos para packaging sostenible María José Tomás (CDTI)
16:35	Mesa redonda: Retos y oportunidades de los adhesivos en el sector de los envases
17:00	<i>Clausura</i> Workshop

Jueves 16 noviembre 2023

9:30 *Apertura XXII Congreso Internacional de Adhesión y Adhesivos*

9:40* Reshaping the future of the adhesive industry through the sustainability
F. Arán Aís (GEAA, España)

Sesión 1: Síntesis y formulación de adhesivos

Moderador: Sonia Florez (Tecnalia, España)

10:20 Synthesis and characterization of reversible polyurethane adhesives via Diels-Alder functionalization
M.A. Moyano (INESCOP, España), M.P. Carbonell-Blasco, C. Hernández, F. Arán-Aís, E. Orgilés-Calpena, F.J. Sierra-Molero, I.M. Pastor, D.A. Alonso

10:40 Estrategias de mejora de las propiedades de adhesión en termoestables tiol-acrilato-epoxi mediante procesado de curado dual secuencial
S- De la Flor (Universitat Rovira i Virgili, España), C.Russo, X. Fernández-Francos, D. Santiago

11:00 Nuevas formulaciones de poliuretano biobasadas
O. Echeverría (Tecnalia, España), I. Harismendy, B. Pérez, S. Flórez, A. Eceiza

11:00-11:40 **COFFEE BREAK**

11:40 PSAs base agua híbridos acrílico-poliuretano biobasados
N. Fernández, O. Echeverría, I. Calafel, R. Rodríguez (Tecnalia, España)

Sesión 2: Impacto ambiental de los adhesivos

Moderador: Francisca Arán (INESCOP, España)

12:00 Reducción del impacto ambiental en adhesivos de poliuretano
C. Hernández-Fernández (INESCOP, España), C. Ruzafa-Silvestre, A. Moyano, M.P. Carbonell-Blasco, F. Arán-Aís, E. Orgilés-Calpena

12:20 Environmental assessment of commercial vs. Biobased adhesives: A technical comparative analysis
B. Mateu-Romero (INESCOP, España), C. Ruzafa-Silvestre, F. Arán-Aís, A.B. Muñoz-Milán, E. Orgilés-Calpena

12:40-14:00 **LUNCH**

14:00* Adhesivos y piedra natural
A.M. Romerosa (Universidad de Almería, España)

14:40 ¿Cómo afecta el nuevo reglamento REACH a los adhesivos, selladores y espumas de poliuretano?
G. Blanco (SIKA, España), Y. Serrano

Sesión 3: Aplicaciones de adhesivos de interés industrial

Moderador: Juan Carlos del Real (Universidad Pontificia Comillas, España)

15:00 Nuevos materiales compuestos de matriz termoplástica líquida reforzada con prepreg aeroespacial caducado reciclado por vía mecánica
J.A. Butenegro-García (Universidad Carlos III de Madrid, España), M. Bahrami, M.A. Martínez-Casanova, J. Abenojar-Buendía

15:20 Estudios previos de adhesión y durabilidad de recubrimientos sobre caucho para neumáticos
M.A. Martínez-Casanova (Universidad Carlos III de Madrid, España), J. Abenojar-Buendía, D. Garcia-Pozuelo Ramos, I. Requena, J.A. Butenegro-García

Autor subrayado-> ponente
*Ponencia plenaria

15:40-16:10	COFFEE BREAK
16:10	Aportación del metacrilato al curado de adhesivos de cianocrilato B. Pérez Allende, O. Echeverría Altuna, J. Abenojar Buendía (Universidad Carlos III de Madrid, España), S. Flórez Fernández, M.A. Martínez Casanova
16:30	Enhancing Adhesive Bonding Personnel's Expertise: European Adhesive Bonder A.O. Barbosa (INEGI, Portugal), E. Meiß, A. Almeida, T. Avelino, F. Mañas, M. Uran, M. Tonnhofer, E.A.S. Marques, R.J.C. Carbas, L.F.M. da Silva
16:50	Migración de adhesivos utilizados en corchos para champagne P. Vera Estacho (Universidad de Zaragoza, España), E. Canellas Aguarrelles, C. Nerin de la Puerta
17:10	DIN 2304 versus din 6701. Importancia de la normativa para la seguridad en las uniones adhesivas A. Sastre Pascual (CESOL, España)
17:30	Cierre
17:40-18:10	Asamblea General Grupo Español de Adhesión y Adhesivos (GEAA) (sólo socios)
20:30	Cena de gala

Viernes 17 noviembre 2023

9:00*	Claves de la actualidad normativa en materia de envases y residuos de envases: nuevas tendencias en torno a la circularidad M.B. García (PACKNET, España)
Sesión 4: Ingeniería de la adhesión Moderador: Miguel Ángel Martínez (Universidad Carlos III de Madrid, España)	
9:40	Análisis del comportamiento mecánico de uniones adhesivas flexibles expuestas a altas temperaturas F.J Simón-Portillo (Universidad Miguel Hernández de Elche, España), O. Cuadrado-Sempere, L.F.M. da Silva, M. Sánchez-Lozano
10:00	Mecanismos de re-adhesión y reciclaje de adhesivos vitriméricos D. Santiago (EURECAT, España), M. Surós, P. Verdugo, S- De la Flor
10:20	Cinética de descomposición y estimación de tiempo de vida de materiales compuestos termoplásticos reforzados con rCFRP J. Abenojar Buendía (Universidad Carlos III de Madrid, España), G.M. Aparicio, J.A Butenegro García, M. Bahrami, M.A. Martínez Casanova
10:40-11:00	COFFEE BREAK
Sesión 5: Técnicas de caracterización de adhesivos y superficies Moderador: Juana Abenojar (Universidad Carlos III de Madrid, España)	
11:00*	Validation of the use of average stress to express tensile bond strength from ISSF=const N.A. Noda (Kyushu Institute of Technology, Japón)
11:40	Examination of adhesive strength of lap joints with different joint end shapes using the interface crack model K. Oda (Oita University, Japón), M. Takeo, H. Oda, K. Ide
12:00	ISSF analysis to express the adhesive strength of the stepped-lap joint R. Takaki (Nippon Bunri University, Japón), N.A. Noda, B. Wang
12:20	Aplicación de la inteligencia artificial en la identificación de defectos en uniones adhesivas empleando el método de resonancia sónica C. Teis, J. Fontana, L. Molisani, R. O'Brien, Y. Ballesteros, J.C. del Real (Universidad Pontificia Comillas, España)
12:40	Presentación EURADH2025 y XXIII Congreso Internacional de Adhesión y Adhesivos
12:50	Premio a la Mejor Presentación 2023
12:40	Clausura del congreso
13:00	LUNCH